

放熱絶縁接着シート 『EA 高Tgシリーズ』

使用例

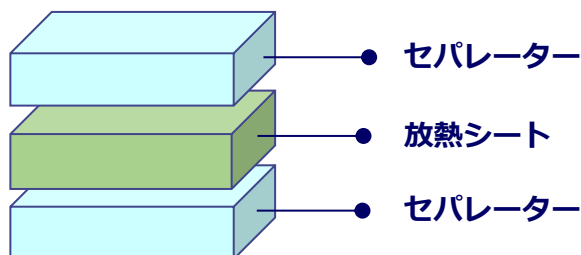
- ・パワーモジュール
- ・LED用基板
- ・インフラ、太陽光発電用基板材料



特徴

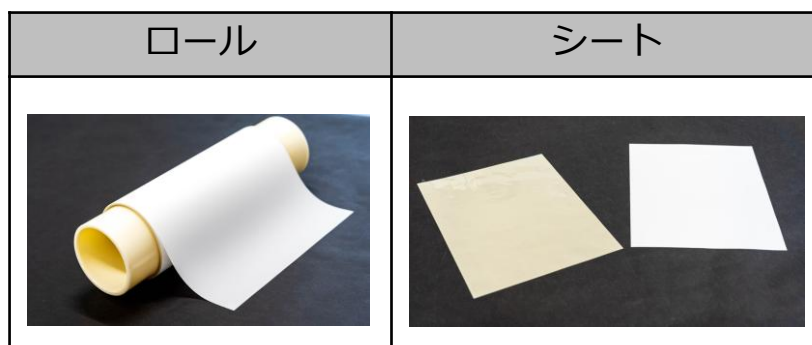
- ・放熱性、絶縁性、接着性を有する未硬化の接着シートです。
- ・いずれも高Tgの製品で、厚さは品種により10～200μmを取り揃えています。

構成



ご要望により構成変更は可能です。

出荷形態



特性

製品名		EA F	EA J	EA H	EAM	EAP 開発品
特徴	-	薄膜	汎用	高放熱	高放熱	高放熱
熱伝導率(LF)	W/m・K	1	3	10	15	18～20
Tg(DMA)	℃	≥200	≥200	≥200	≥200	≥180
耐電圧	hr	>1000	>1000	>1000	>1000	—
冷熱衝撃	cycle	>1000	>1000	>1000	>1000	—

※加工時の推奨条件 プレス条件：180℃×Hold60min×3～20MPa

※耐電圧 150℃×DC1kV

※冷熱衝撃 -40℃⇔150℃